

Title (en)

PROCESS AND DEVICE FOR CENTRIFUGAL CASTING OF COPPER AND COPPER ALLOYS.

Title (de)

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SCHLEUDERGIESSEN VON KUPFER UND KUPFERLEGIERUNGEN.

Title (fr)

PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LA COULEE CENTRIFUGE DU CUIVRE ET DES ALLIAGES DE CUIVRE.

Publication

EP 0445140 A1 19910911 (DE)

Application

EP 89912616 A 19891120

Priority

AT 291588 A 19881128

Abstract (en)

[origin: WO9006196A2] In a process for centrifugal casting of copper, copper alloys and other alloys affected by oxygen, in particular bronze, at least one flux is introduced into the mould in order to limit or prevent the formation of an oxide film on the inner surface of the casting. The flux, in the form of solid borax, preferably powdered and possibly mixed with fine particulate metals with an affinity for oxygen, e.g. Mg, Li, Cer and/or powdered graphite and/or chamotte and/or charcoal, is applied in a layer 0.5 to 4 mm thick, preferably 1 to 3 mm, immediately after casting on the still molten inner surface of the casting.

Abstract (fr)

Procédé pour la coulée centrifuge du cuivre et des alliages de cuivre ou d'autres alliages sensibles à l'oxygène, en particulier le bronze, au moins un fondant étant incorporé au moule afin d'éviter ou de limiter la formation d'une couche d'oxyde sur la surface interne de la pièce moulée. On applique en tant que fondant sur la surface interne encore liquide de la pièce moulée, immédiatement après l'opération de coulée, du borax solide, de préférence sous forme de poudre, le cas échéant avec des mélanges de fines particules de métaux à affinité pour l'oxygène, par exemple Mg, Li, Cer et/ou de la poudre de graphite et/ou de chamotte et/ou de charbon de bois, le tout sous la forme d'une couche d'une épaisseur de 0,5 à 4 mm, de préférence de 1 à 3 mm.

IPC 1-7

B22D 13/10

IPC 8 full level

B22D 13/02 (2006.01); **B22D 13/10** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B22D 13/02 (2013.01 - EP US); **B22D 13/10** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

See references of WO 9006196A2

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE ES FR GB IT LI SE

DOCDB simple family (publication)

WO 9006196 A2 19900614; **WO 9006196 A3 19900726**; AT 392228 B 19910225; AT A291588 A 19900815; AT E90897 T1 19930715; CA 2004061 A1 19900528; CA 2004061 C 19970225; EP 0445140 A1 19910911; EP 0445140 B1 19930623; US 5193604 A 19930316

DOCDB simple family (application)

AT 8900105 W 19891120; AT 291588 A 19881128; AT 89912616 T 19891120; CA 2004061 A 19891128; EP 89912616 A 19891120; US 65930291 A 19910508